

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-037

## 浙江亨通控股股份有限公司 关于对全资子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司
	增加前预计 2026 年担保额度	150,000.00 万元
	增加后预计 2026 年担保额度	210,000.00 万元
	本次担保金额	60,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	142,664.58 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不适用：2026 年新增担保额度预计
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不适用：2026 年新增担保额度预计

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	182,664.58
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	50.31
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%

	<input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

公司第九届董事会第二十七次会议和 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度为亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）提供担保额度不超过 150,000.00 万元的担保，为亨通（内蒙古）生物科技有限公司提供担保额度不超过 50,000.00 万元的担保，为浙江拜克生物科技有限公司提供担保额度不超过 30,000.00 万元的担保，为亨翔（海南）国际贸易有限责任公司提供担保额度不超过 30,000.00 万元的担保，为江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司提供担保额度不超过 10,000.00 万元的担保，为德清壬思实业有限公司提供担保额度不超过 5,000.00 万元的担保，为 2026 年度新设立或纳入合并范围的其他下属控股企业提供合计不超过 25,000.00 万元的担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。上述担保额度合计金额为：人民币 300,000.00 万元。上述担保预计额度有效期为 2026 年度。

为进一步满足公司合并范围内子公司 2026 年度日常生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司 2026 年度拟为公司全资子公司亨通铜箔提供新增担保额度不超过 60,000.00 万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次增加额度后，公司及控股子公司拟为全资子公司亨通铜箔提供担保总额度不超过 210,000.00 万元的担保。除亨通铜箔增加担保额度外，其他控股子公司 2026 年度预计担保额度未发生变化。

### （二）内部决策程序

公司于2026年6月15日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时提请股东会授权公司董事长或其授权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件,本次担保额度及相关授权的有效期为2026年度。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持方比例	被担保最近一期资产负债率	担保方最近一期资产	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额(万元)	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保度上公最一净资产	担保预计效	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司											
被担保方资产负债率超过 70%											
浙江亨通控股股份有限公司及其控制的企业	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司	100%	84.54%	142,664.58	60,000.00	16.53%	2026年度	否	否		

注:上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2025

年 12 月 31 日的财务数据（经会计师事务所审计）。

上表为 2026 年度公司预计新增对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、银行承兑汇票、保函等业务。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	张卫强		
统一社会信用代码	91510600MA7EDEMJ74		
成立时间	2021 年 12 月 8 日		
注册地	四川省德阳市旌阳区八角井街道雪山路 888 号（南湖路与雪山路交汇处西南角）		
注册资本	90,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未 经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	263,671.61	233,672.08
	负债总额	229,069.77	197,555.48
	资产净额	34,601.84	36,116.60
	营业收入	56,419.08	132,232.06

	净利润	-1,779.55	-11,046.45
--	-----	-----------	------------

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司对本次新增担保尚未签订担保协议，上述预计担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司及子公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议。同时提请股东会授权公司董事长或其授权代表在担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。本次担保额度及相关授权的有效期为2026年度。本次担保无反担保。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司及子公司经营发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为全资子公司提供担保，风险可控，被担保对象具备偿债能力，相关子公司目前各方面运作正常，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司于2026年6月15日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为下属控股企业提供的对外担保总额为182,664.58万元，占公司最近一期经审计净资产的50.31%。公司不存在对控股

股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年6月16日